



tesa HAF® 8430

제품 정보



45µm 황색 반응성 HAF 마운팅 테이프

제품 설명

tesa® HAF 8430은 페놀 수지와 니트릴 고무로 된 열활성 양면 황색 접착 필름입니다.

특성:

- 안정적인 칩 점착력
- PVC, ABS, PET, 폴리카보네이트 카드에 적합
- 일반적인 삽입 공정에서의 우수한 작업성
- 뛰어난 내노화성
- 고무 함량이 높아 제품 전기간에 걸쳐 유연성 유지

특성

- 신뢰할 수 있는 칩 모듈 본딩
- PVC, ABS, PET 및 PC 카드에 적합 * 모든 일반 인플랜팅 라인에 대한 작업 용이성
- 뛰어난 내노화성
- 고무 함량이 높아 장기간(lifelong) 유연성 제공
- tesa HAF® 8430 제품은 상온에서 끈적이지 않음

Applications

tesa® HAF 8430은 스마트 카드에 칩 모듈을 삽입하는 용도로 설계된 제품입니다.

Technical Information (average values)

The values in this section should be considered representative or typical only and should not be used for specification purposes.

제품 구조

- | | | | |
|----------|-----------------|-------|-------|
| • 기재 소재 | 없음 | • 총두께 | 45 µm |
| • 접착제 종류 | 니트릴고무 / 페놀수지 | • 컬러 | amber |
| • 이형지 종류 | 글라신지 | | |

속성 / 성능 값

- | | | | |
|---------------|----------------------|---------------|----------------------|
| • 점착력 (동적 전단) | 12 N/mm ² | • 점착력 (푸쉬 아웃) | 12 N/mm ² |
|---------------|----------------------|---------------|----------------------|



tesa HAF® 8430

제품 정보

비고

Technical recommendations for Smart Card applications:

tesa HAF® 8430 is not self adhesive. It is activated by heat and pressure over a certain interval. The following values are recommendations for machine parameters to start with. Please note that optimum parameters strongly depend on the type of machine, particular materials for card bodies and chip modules as well as customer requirements.

1. Pre-lamination:

During pre-lamination, the adhesive tape is laminated onto the module belt. The pre-lamination step does not affect the shelf life time of the adhesive tape. Pre-laminated belts can be stored over the same period of time as the adhesive tape.

Machine setting:

- Temperature 120 – 140 °C
- Pressure 2 – 3 bar
- Time 2.5 m/min

2. Module embedding:

During module embedding, the pre-laminated modules are cut from the module belt, positioned into the card cavity and permanently bonded to the card body by heat and pressure. Depending on the type of implanting line, single-step or multiple-step process are possible. Today, most implanting machines have multiple heat press steps.

Single-step process - machine setting:

- Temperature¹ 180 – 200 °C
- Pressure 65 – 75 N/module
- Time 1.5 s

Multiple-step process - machine setting:

- Temperature¹ 180 – 200 °C
- Pressure 65 – 75 N/module
- Time 2 x 0.7 s / 3 x 0.5 s

¹ Temperature measured inside the heating stamp. Different temperature settings recommended for different card materials:

PVC and ABS: 180 – 190 °C

PET and PC: 190 – 200 °C

Bonding strength values were obtained under standard laboratory conditions. Value is specification limit checked for each production batch (material: etched aluminum test specimen / bonding conditions: Temp. = 120 °C; pressure = 10 bar; time = 8 min). To reach maximum bonding strength, surfaces should be clean and dry.



tesa HAF® 8430

제품 정보

면책사항

테사에서 판매하는 제품들은 엄격한 품질관리를 통해 생산되고 있으며, 테사에서 제공하는 전문적인 정보들은 오랜기간의 경험을 기반으로 하고 있습니다. 관련 정보는 평균값에 근거하며, 특별한 용도에는 적합하지 않을 수 있습니다. tesa SE는 관련 정보의 명시적 또는 암묵적인 보증을 하는 것은 아니며, 이는 특별한 용도에 적합성 또는 상업성과 관련한 어떠한 암묵적인 보증도 포함하지 않습니다. 사용자는 제품을 사용하기 전에 적용부위에 적합한지를 검토하시기 바라며, 기타 문의사항이 있으시면 저희 직원에게 문의 바랍니다



최신정보는 왼쪽 링크를 클릭하세요. <http://l.tesa.com/?ip=08430>